

第1回 LPB Forum

Nimbic

LPBフォーマットとCloudによる
最新電磁界解析テクノロジー

2013.03.06

Stay Shift Co.,LTD

Kazuhiro Kadota

Agenda

- Nimbicについて
- Nimbic製品のご紹介
 - 各製品について
 - クラウドを用いた電磁界解析
- JEITA LPBフォーマットのサポート

Nimbic製品について



nCloud

- nWave, nApexをCloud環境を用いて解析



nWave

- S-parameter抽出ツール



nApex

- LCRG抽出ツール



nVolt

- PI解析ツール(電源/GNDプレーン解析)



nBand

- Net品質チェッカー(nWaveを利用可)

nView

- Pre/Post

nPass

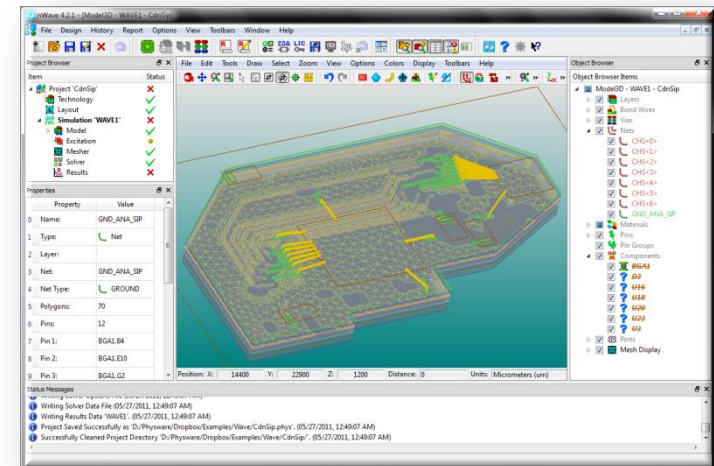
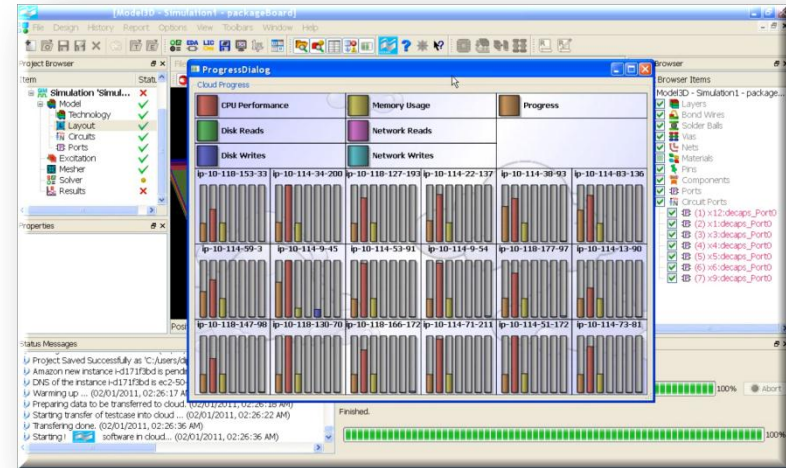
- S-parameterのPassivity問題のチェック/修正ツール

nNets

- Netlist出力オプション

nAcad

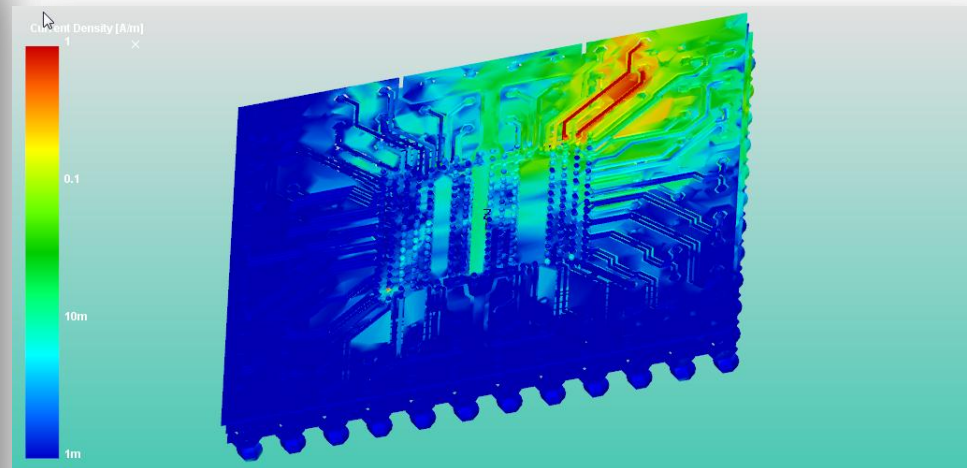
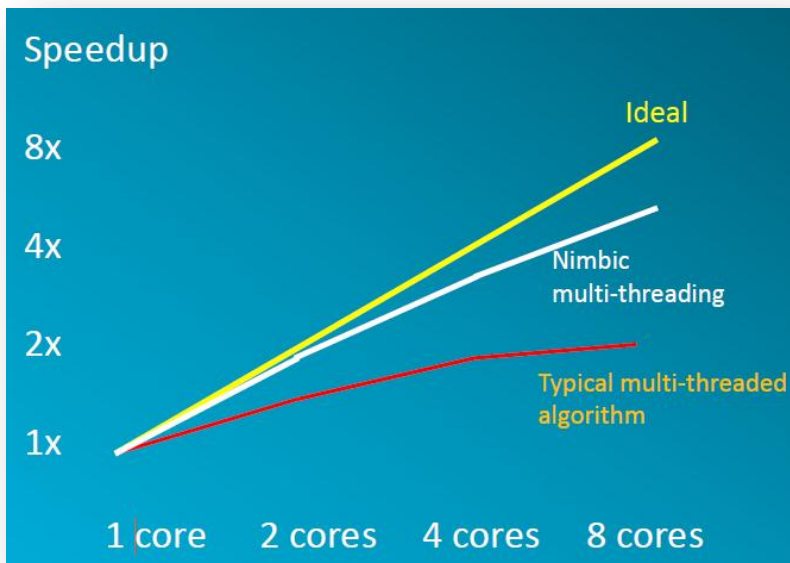
- DXFファイルImportオプション



Nimbic製品について

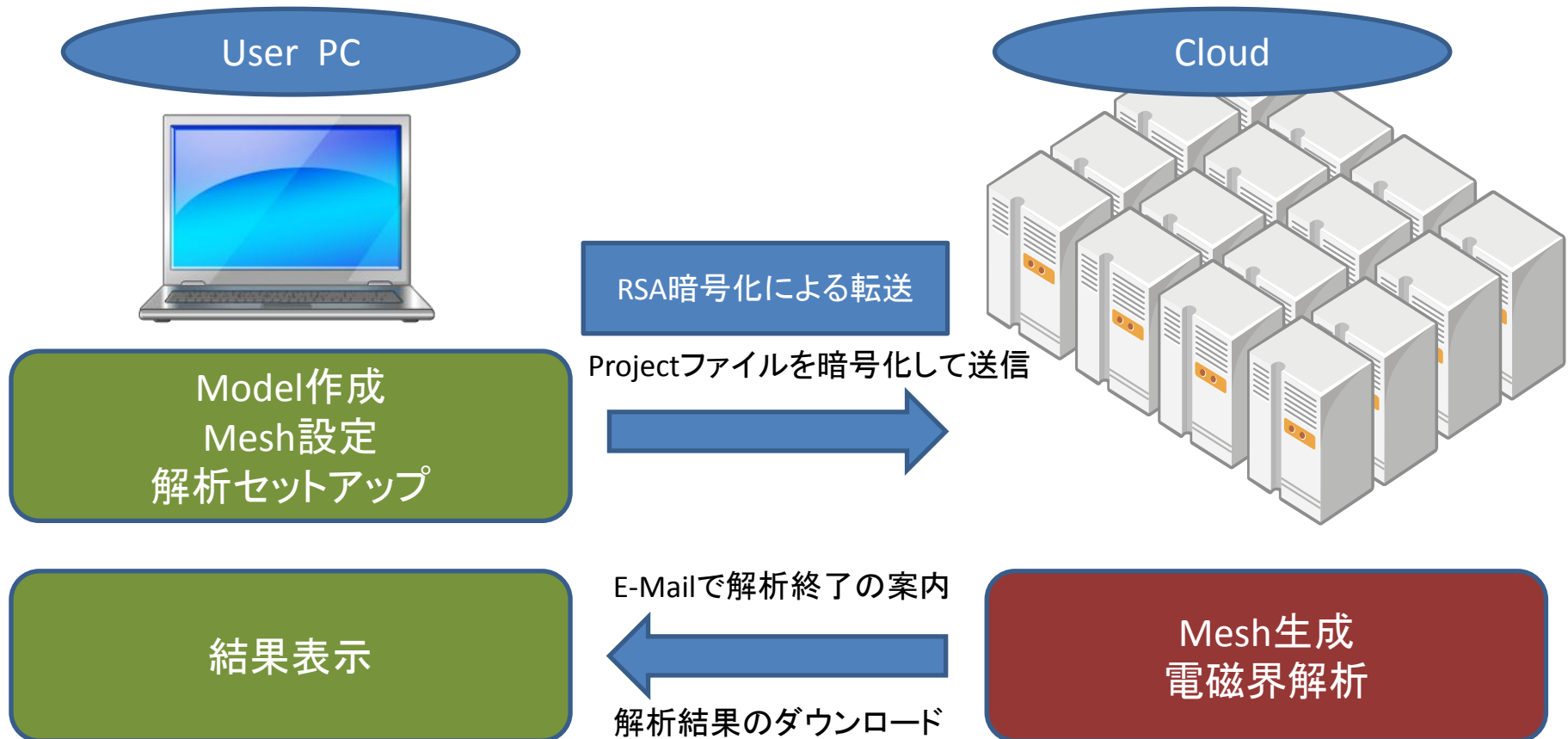
■ 製品の特長

- Package/PCB特性解析に特化した電磁界解析ツール
 - Package/PCBのレイアウトからシミュレーションまでのユーザーの設定を少なくし、効率的な解析を実現
- 独自の高速境界要素法による高速な大規模モデルの解析
 - マトリクスの並列処理能力を持ち次世代大規模マトリクス計算が可能
- 3D電磁界ソルバであるので、BGA, Bondwire, リードフレームの解析も可能
- 図研、Cadence、MentorなどのデータをダイレクトにImport可能なシームレスなECADリンク機能
- 解析結果から自動的にグラフ作成
- Amazon Cloud環境を用いたCloud Computingによる大規模モデルの超高速解析



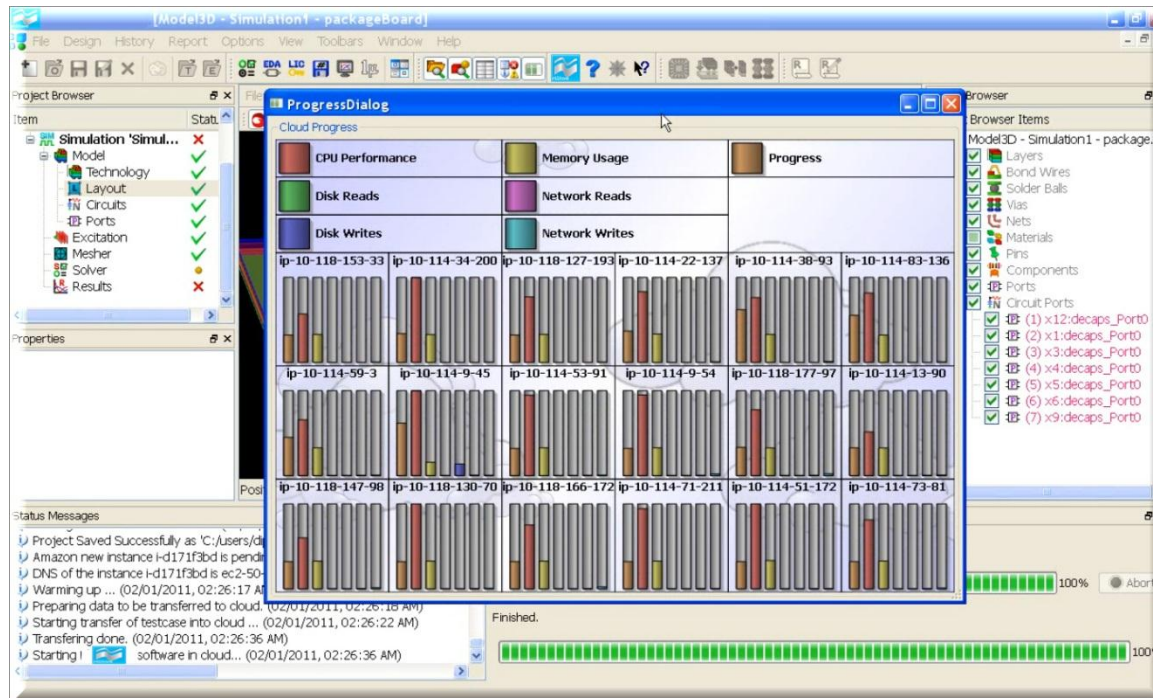
nCloudによる解析

- nCloudはNimbicのクラウドソリューション（Amazonクラウドを使用）
- nCloudライセンスを導入されたユーザーにはPre/PostツールのnViewを提供
- nCloud上ではnApexでのRLGC抽出、nWaveによるSYZ-parameter抽出、電流分布解析が可能
- クレジットカード決済も可能



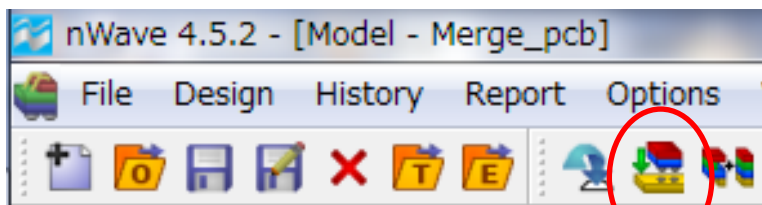
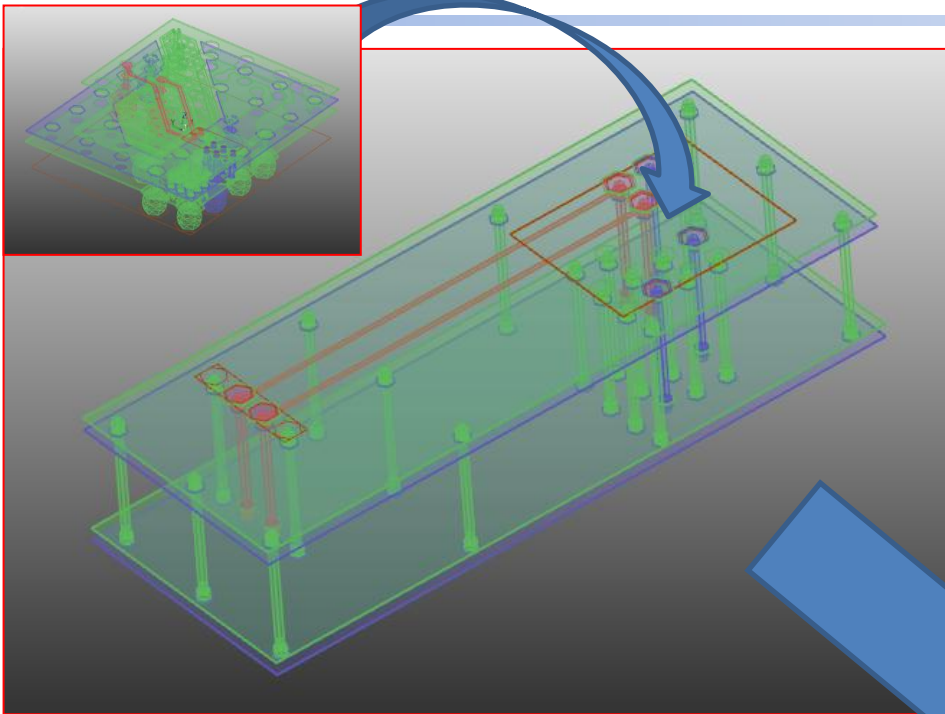
nCloud のメリット

- 並列して多くのジョブを実行することができる
 - コストは複数のジョブを連続して実行した場合と同じ
- 1つのモデルに対しての分散解析に数十もの並列処理をもちいることができる
 - 1つのモデルを独自のマトリクス並列処理機能によって高速な解析を実現
- 自社で高価なハードウェアを購入する必要がない
- 必要な時に必要な分のコアを使用して解析を実行
- 電磁界解析にかかるコストを低減

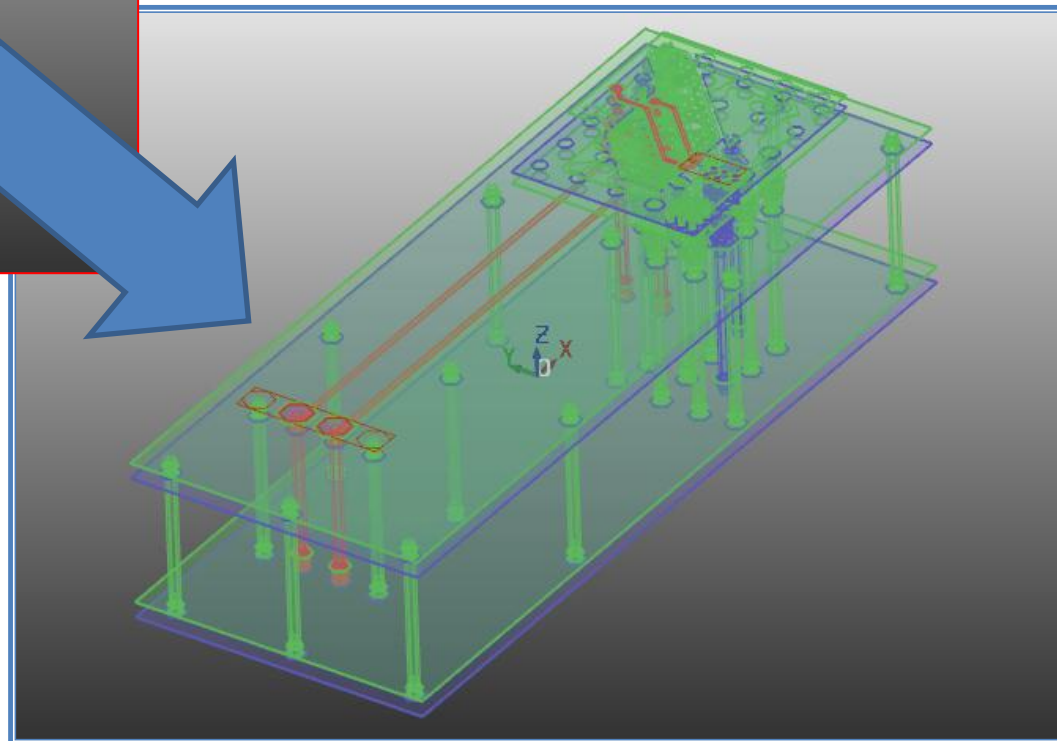


Package+Board 解析

- TSV+RDLと同様にPackage Modelと Board Modelをマージすることにより、 Chip+Package+Boardの電磁界解析が可能
- LPBフォーマットを用いることで更に容易に協調解析が可能



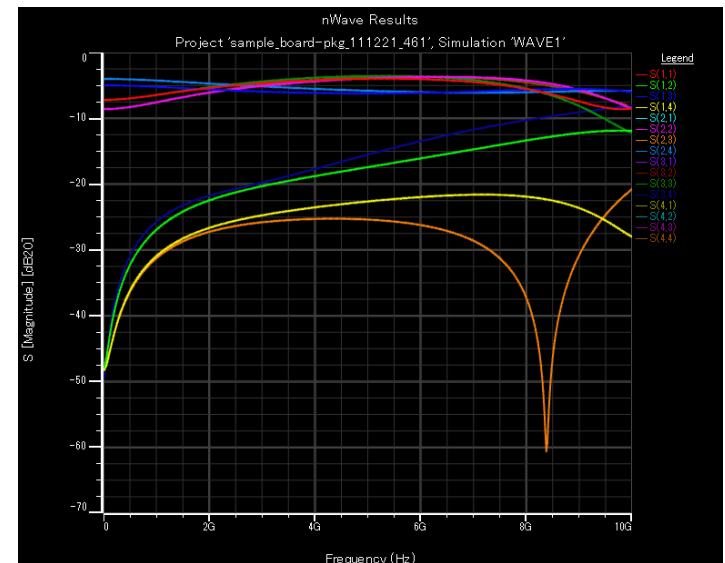
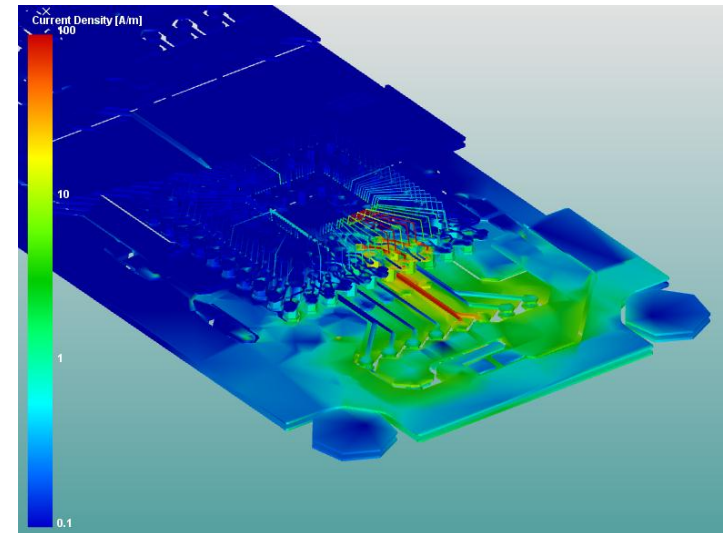
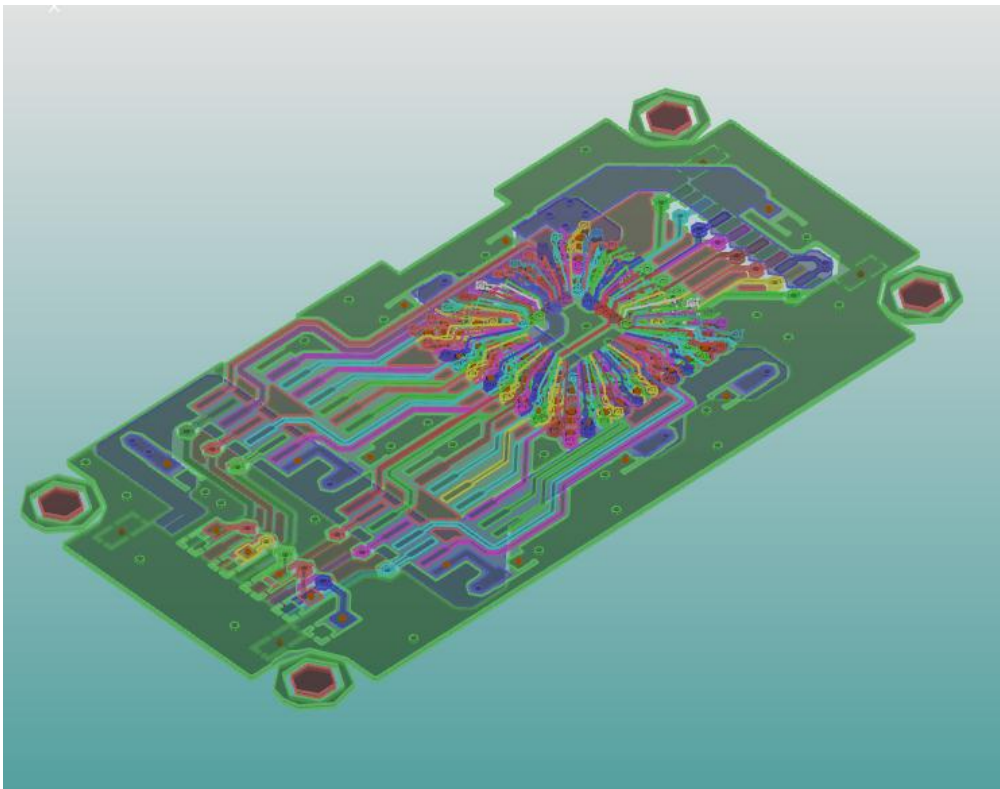
アイコンのクリックで、マージユーティリティが起動



nWave Bench Mark例

■ Package + Board 解析(2Port)

- 解析周波数: 10MHz~10GHz
- Mesh: 95480 elements
- CPU : Intel i7-2670QM 2.2GHz 8core
- 使用Memory: 8.9GB
- 解析時間: 163min (2.7hour)



JEITA LPBフォーマットのサポート

- 現バージョンではLPB ver2.0 のG,M Formatに対応
- G-FormatをImportダイアログで選択してImportすると指定したLayoutの電磁界モデルを生成
- BoardのM-FormatをImportダイアログで選択してImportするとM-Format内に記述されたDie、PackageおよびBoardのG-Formatを一括でImportして各モデルを作成
- 今後、C-Format(コンポーネント情報)のサポートが完了すると、M-Formatで読み込んだ各モデルをマージして協調解析モデルを一括で行うことが可能となる

Multi-Chip Module (*.mcm)
Board Layout (*.brd)
System in Package (*.sip)
GDSII (*.gds *.gdsii *.gds2 *.sf *.strm)
DXF (*.dxf)

Layout Format 1 (*.xfl)

→ G-Format

Caltech Intermediate Form (*.cif)

Mentor Layout (*.hkp)

HyperLynx Layout (*.hyp)

Zuken Layouts (*.pcb *.rif *.pcf *.ftf)

JEITA LPB Project (*.xml)

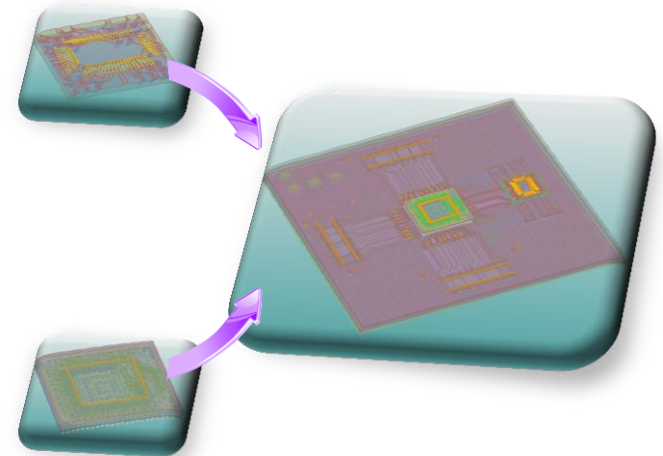
→ M-Format

Nimbic ASCII Model - Text (*.pam)

Nimbic Saved Geometry - Binary (*.geom)

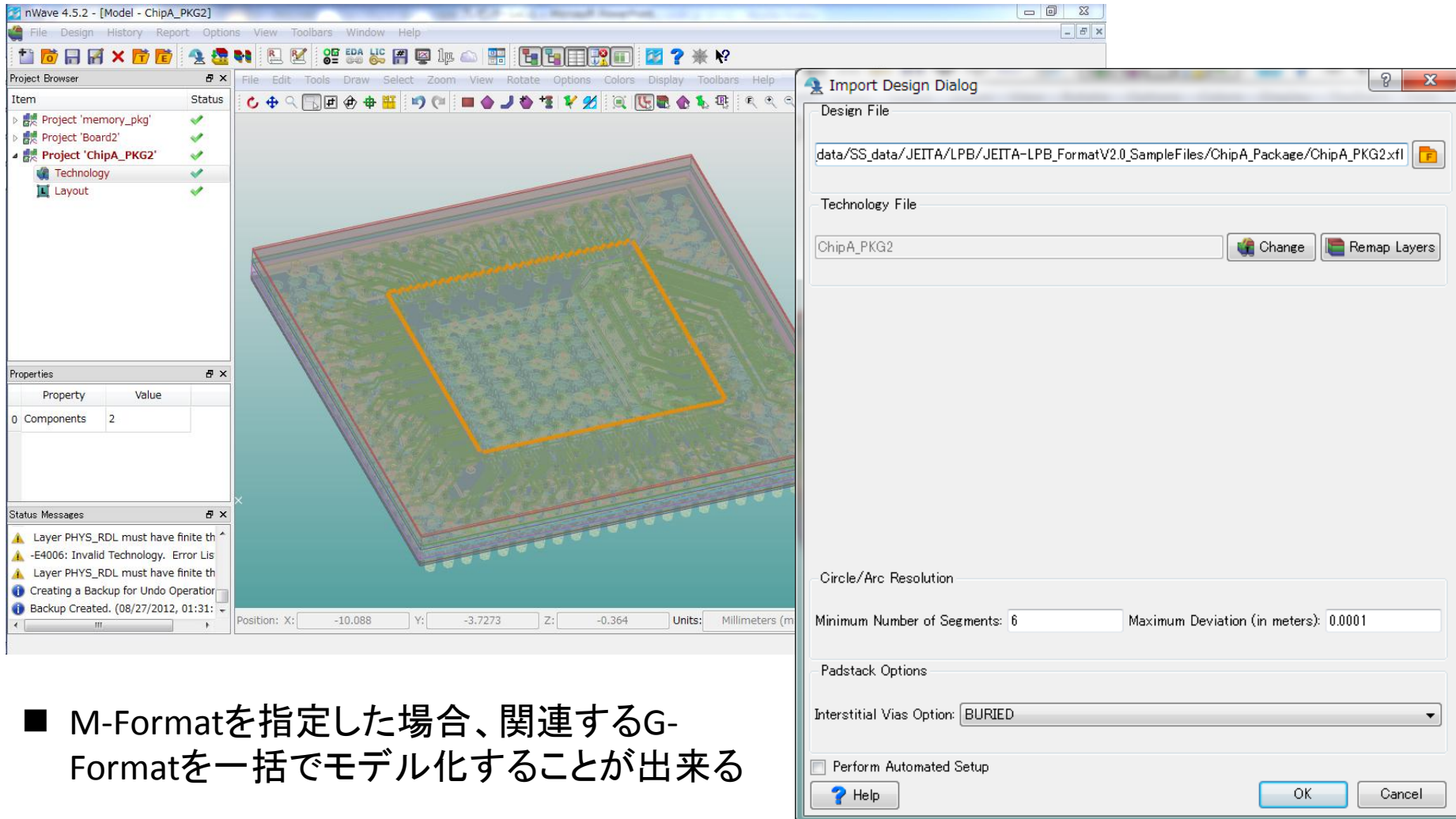
Boolean Scripting Language (*.bool)

All Files (*)



Layout Import

■ LPB G-formatデータ(XFLファイル)をImportダイアログで指定



The screenshot displays the nWave 4.5.2 software interface. The main window shows a 3D perspective view of a circuit board layout with a green surface and various components. An orange rectangular outline is visible on the top surface. The left sidebar contains a Project Browser with a tree view showing 'Project 'memory_pkg'', 'Project 'Board2'', 'Project 'ChipA_PKG2'', 'Technology', and 'Layout'. Below it is a Properties panel with a table showing '0 Components' and a value of '2'. The bottom status bar shows coordinates: Position: X: -10.088, Y: -3.7273, Z: -0.364, Units: Millimeters (m).

The 'Import Design Dialog' box is open on the right side of the screen. It contains the following fields and options:

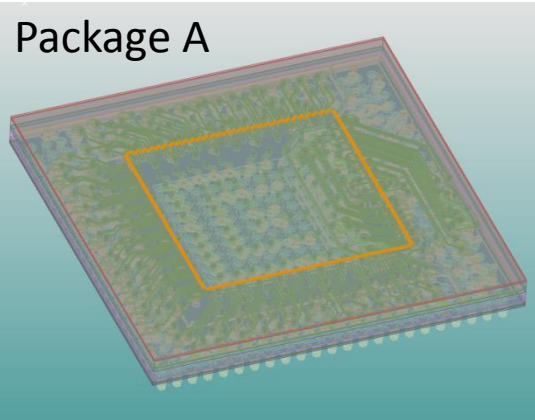
- Design File:** data/SS_data/JEITA/LPB/JEITA-LPB_FormatV2.0_SampleFiles/ChipA_Package/ChipA_PKG2.xfl
- Technology File:** ChipA_PKG2
- Buttons:** Change, Remap Layers
- Circle/Arc Resolution:** Minimum Number of Segments: 6, Maximum Deviation (in meters): 0.0001
- Padstack Options:** Interstitial Vias Option: BURIED
- Buttons:** OK, Cancel
- Checkboxes:** Perform Automated Setup (unchecked), Help (icon)

■ M-Formatを指定した場合、関連するG-Formatを一括でモデル化することが出来る

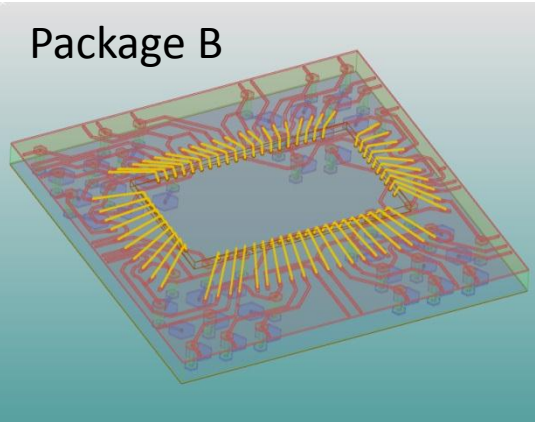
G-Formatによるモデル化

- PackageA, PackageB, BoardのXFLファイルを指定してImportし、モデル化

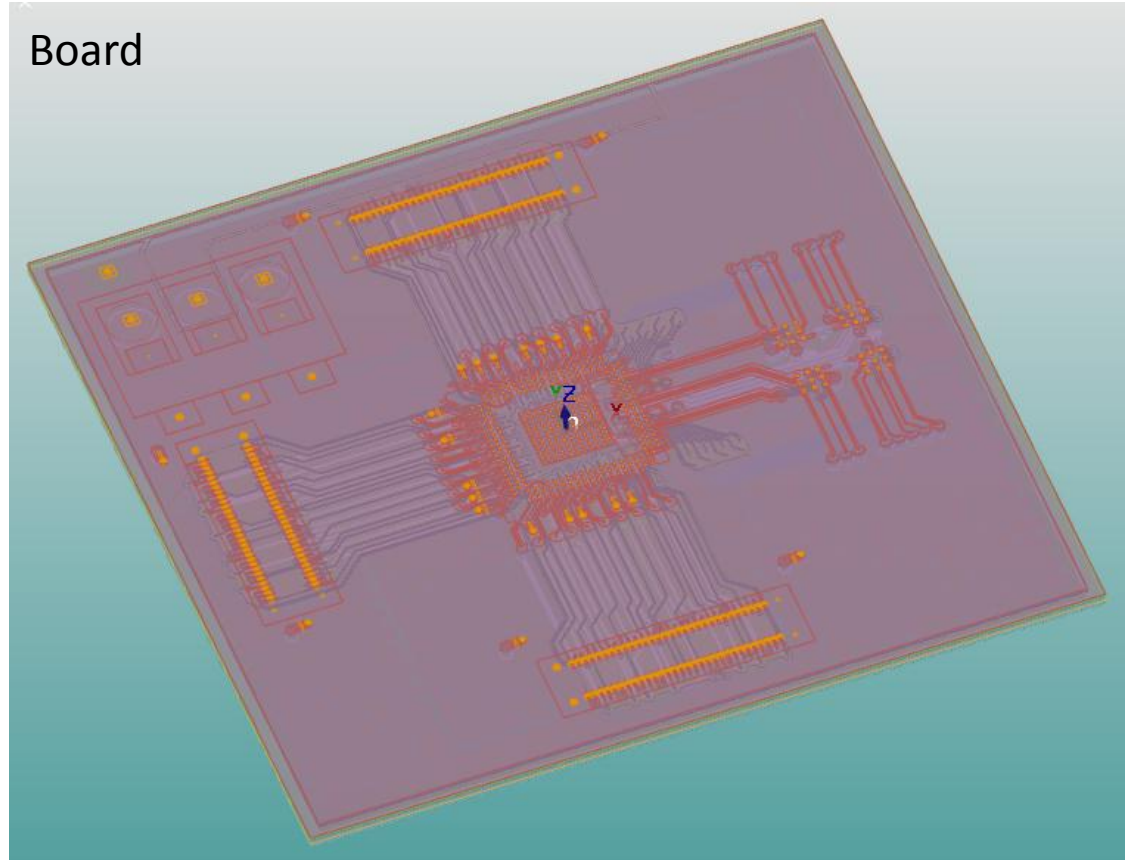
Package A



Package B

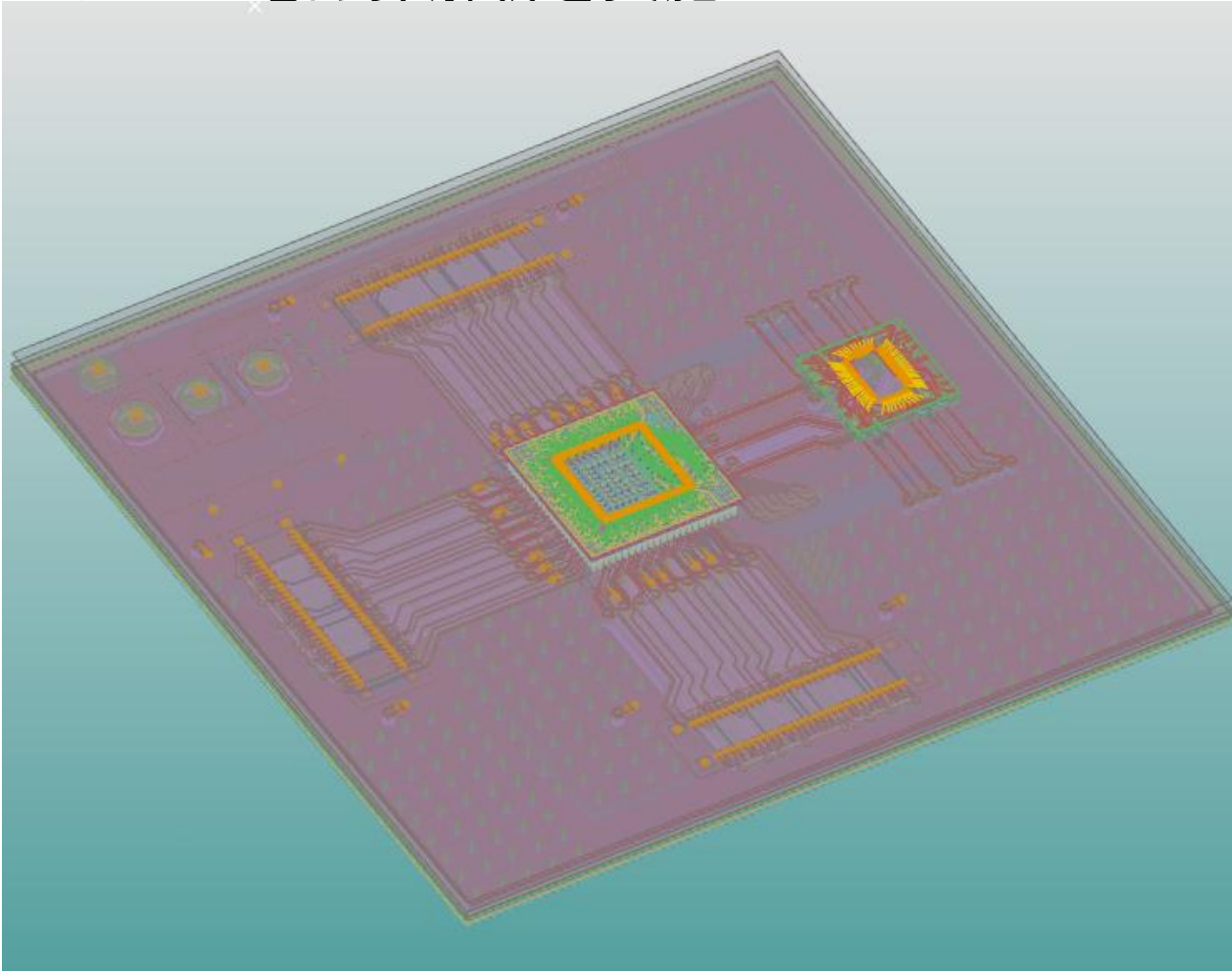


Board



PackageA+PackageB+Board

- PackageA、PackageBのモデルをBoardモデルにマージ
- 全体モデルの電磁界解析を実施



■ Nimbic

- LPB Formatが生きる電磁界ツール

■ LPB Formatへの対応

- 現バージョンではG,M Formatのみの対応であるが、今後他のFormatへの対応も進めていきたい
- 対応を加速化するためには、具体的にLPBを使ってどのような連携をしていき、どのようなメリットを生むのかをベンダーが認識する必要がある